

即日発表用

投資家向け広報窓口:

エド・ロックウッド
インバスターリレーションズ部門シニアディレクター
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

メディア向け広報窓口:

ベッキー・ハウランド博士
コーポレートコミュニケーション部門シニアディレクター
(408) 875-9350
becky.howland@kla-tencor.com

新製品発表 Kronos™ 1080 および ICOS™ F160 検査システム KLA-Tencor の IC パッケージシステム用製品ラインを拡充

カリフォルニア州ミルピタス、2018 年 8 月 30 日付 [KLA-Tencor Corporation](#) (NASDAQ: KLAC) は、多種多様な IC パッケージの課題に対応できる欠陥検査装置の新製品2機種を発表しました。**Kronos™ 1080** システムは、製造ラインの高度なパッケージ技術に対応する高感度ウエハー検査システムであり、プロセスコントロールおよび材料処理工程における重要な情報を提供します。**ICOS™ F160** システムは、ダイシング後の IC パッケージを外観検査するシステムであり、主要欠陥タイプごとに素早く、正確に仕分けします。更に、側面のクラック、ハイエンド パッケージ製品の歩留まりに影響する新たな欠陥にも対応しています。これら 2 機種の検査装置は、KLA-Tencor の欠陥検査装置、計測・データ分析システム製品ラインアップに加えられ、IC パッケージ歩留まりとダイソート精度向上に貢献いたします。

「IC チップの微細化が減速するにつれ、チップパッケージ技術の高度化がデバイスの高性能化にとり重要な手段になりました。」と KLA-Tencor 上級副社長兼最高マーケティング責任者の Oreste Donzella は話します。「パッケージされたチップは多様なデバイス用途に適うように、デバイス性能や消費電力、フォームファクター、そしてコストという目標を同時に達成する必要があります。結果として、パッケージ デザインは、より多様で複雑になり、各世代の製品は 2 次元 および 3 次元構造において、より高密度パッケージとなりかつサイズも縮小されています。それと共に、パッケージされたチップの価値は大幅に増大し、電子機器メーカーの品質と信頼性に対する期待も大きくなりました。これらの期待に応えるために、パッケージ メーカーは、IC 製造ファブのバックエンド工程メーカーであっても、あるいはアッセンブリーから試験を請け負う製造メーカー (OSAT) であっても、より高感度で費用効果の高い検査や計測・データ分析、そしてより高精度で不良部分の識別ができる装置を求めています。当社の技術チームは、新製品 Kronos 1080 および ICOS F160 システムの開発により、多様なパッケージング タイプに対応できる欠陥検査を求めるエレクトロニクス産業の拡大するニーズに応えました。」

この **Kronos 1080** システムは、先進的なウエハー上のパッケージ プロセス行程を検査できるように開発されており、インラインプロセス管理で求められるすべての欠陥タイプに関する情報を提供いたします。高度なパッケージ技術は、ますます微細化し、より高密度なメタルパターン、そして複数の再配線レイヤーを必然的に含み、これらすべてが技術革新的ソリューションが必要な検査要件を増大させています。Kronos システムは、マルチモード光学系、センサーおよび先進的欠陥検出アルゴリズムにより、業界をリードする性能を達成しております。Kronos システムはさらに、KLA-Tencor の IC チップ製造工程用の優れた検査ソリューションである FlexPoint™ を導入しました。FlexPoint は、欠陥が最も影響を与えるダイの重要な領域で検査を行うシステムです。柔軟なウエハーの取り扱いができることにより、ファンアウトと呼ばれるウエハーレベル パッケージで頻繁に遭遇する非常にゆがんだウエハーの検査も可能です。ウエハーレベル パッケージは、モバイル機器用途で確立されており、ネットワークや構成のコンピュータでも新たに使われ始めています。

ウエハーレベル パッケージでのテスト、ダイシングの後、**ICOS F160** が外観検査とダイソートを行います。モバイル機器のようにハイエンド パッケージを使用するメーカーは、レーザー加工の溝、ヘアラインおよび側面のクラックを検出できる新機能により恩恵を受けます。これらのクラックは、チップ上で高速化と消費電力削減を促進する高密度メタル ルーティングの絶縁材料の変化により引き起こされます。この新材料はもろく、ウエハーダイシング工程でクラックが発生しやすくなります。側面のクラックは、ダイの上面から垂直な方向に発生しているため従来の目視検査では検出が困難なことで知られています。ICOS F160 システムのもう一つの大きな利点は、入出力モードがウエハー、トレイ、またはテープにすることができるという柔軟性にあり、多くのパッケージタイプに有効です。このシステムは機器構成を簡単に変更することができます。装置の自動校正および精密ダイピッキングにより、大容量製造環境における装置の稼働率を高めることができます。

この **Kronos 1080** および **ICOS F160** システムは、KLA-Tencor のパッケージング ソリューション製品ラインの一部を構成し、多様な IC パッケージタイプ向けの検査、計測、データ分析およびダイソーティングニーズに対応する製品です。この製品ラインには [CIRCL™-AP](#) オールサーフィス ウエハー検査システム、[Zeta-580/680](#) ウエハおよびパネル用 3D 計測システム、ICOS™ [T890](#), [T3](#) および [T7 シリーズ](#) コンポーネント検査・計測システム、そして [Klarity®](#) データ分析システムが含まれています。これら新製品欠陥検査システム 2 機種および KLA-Tencor パッケージングソリューション製品ライン全機種については、以下のウェブページ、[パッケージング製品ラインウェブページ](#)をご覧ください。

KLA-Tencor 社について:

KLA-Tencor 社はプロセスコントロールと歩留まり管理ソリューションにおけるトップ企業で、世界中のお客様と協力し最先端の検査/計測技術を開発しています。これらのテクノロジーは、半導体その他の関連ナノエレクトロニクス業界で役立っています。当社は業界標準となる製品のポートフォリオを有するとともに、世界に通用するエンジニアを抱えており、40 年にわたりお客様のために優れたソリューションを作り続けています。KLA-Tencor 社はカリフォルニア州ミルピタスに本社を構え、世界中に専門のカスタマーオペレーション・サービスセンターを配置しています。詳しい情報については www.kla-tencor.com (KLAC-P)をご覧ください。

将来の見通し:

Kronos 1080 and ICOS F160 システムの予想性能に関する史実以外の当プレスリリースの記述および欠陥削減およびパッケージング製造施設におけるダイソート精度改善の経済的効果は将来の見通しであり、1995 年米国証券民事訴訟改革法 (the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) のセーフハーバー (Safe Harbor) 規定に従っています。これらの将来の見通しに関する説明は現時点での情報・期待に基づくもので、種々のリスクと不確実性を含んでいます。新技術の採用の遅れ (コストや性能問題などにより)、他社による競合製品の導入、KLA-Tencor 社製品の使用に悪影響を与える予期しない技術的な問題や限界などを含む様々な因子により、実際の結果は、前述した予測とは大きくかけ離れることがあります。

###